

レビュー

第2回「九州」半導体産業展

(上)

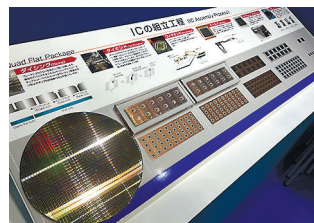
10月8～9日の2日間、「第2回「九州」半導体産業展」が、福岡市のマリンメッセ福岡A館とB館で開催された。会場を前回は1・5倍に拡大した今回は398社（併催の第1回「九州」次世代物流展は146社）が出展し、主催者目標の

1万人を大きく上回る1万3640人（併催展含む）が来場する大盛況となった。

セミナーでは九州の半導体産業で活躍する企業や、メーカーや、それら

のエネルギー消費が従来6倍になるとの見通しを発表した。エネルギーの供給や節約が重要だと述べ、そのなかでトランジスタの微細化、高性能化に向け、構造改革と新

る。そのためのまちづくりが重要だ」と述べ、全国初となる半導体学部を設置した熊本県立大学の構想を発表。従来は多数の学部で横断していた半導体の製造や活用につ



アムコーはICパッケージングプロセスを紹介

新たな研究開発拠点として、4月に福岡市の中洲エリアにR&Dセンターを設立した。スペースの半分がラボ、残り半分がオフィスで、日本における開発のハブ機能を担うための材料を使いこなすための評価や顧客、サプライヤー、大学などとのコラボを行う。また、

国内工場のみならずアムコーグループのグローバル拠点が課題だと指摘。日本メーカーが強みを持つパッケージング関連技術をグローバルに伝える手伝いをアムコーが果たせると強調し、R&Dセンターでの協業を呼びかけた。

展示フロアには、アムコーのほか、九州に立地するデバイスメーカーが複数出展した。三菱電機はパワーデバイス、モジュールのほかビルや工場向けパワーエレクトロニクスソリューションや

会場拡充で1.3万人超が来場

九州半導体の活況ぶりアピール

を支える行政、学術関係者が登壇した。うち熊本県立大学理事長の黒田忠広氏は、「九州における半導体産業のさらなる成長に向けて」と題して講演した。

講演では「AIがエネルギー危機を招く」と危機感を示し、AI関連で

規材の探索の必要性を述べたほか、メモリにおける3D実装については、将来のチップはキュービック型になるだろうとの予想も示した。

そのほか、九州での半導体産業については「アジアの中心である九州に知能を集める必要がある。世界第2位のOSATであるアムコーの日本法人、(株)アムコー・テクノロジー・ジャパン R&Dセンター長の馬場伸治

氏は、九州をはじめとした日本における事業活動を紹介した。同社は世界8カ国に生産拠点を置き、熊本に工場がある。世界とどうつながっていく

点とも連携し、日本の技術を世界に広げる橋渡しをする。馬場氏は、九州には約1000社もの半導体関連企業が所在し、それを

工作機械など半導体に関わる広範な自社製品群を紹介。また、ゲームを通じて積極的にパワーデバイスの動きを体感するデモも実施した。

アムコーはICパッケージングプロセスを紹介

が課題だと指摘。日本メーカーが強みを持つパッケージング関連技術をグローバルに伝える手伝いをアムコーが果たせると強調し、R&Dセンターでの協業を呼びかけた。

展示フロアには、アムコーのほか、九州に立地するデバイスメーカーが複数出展した。三菱電機はパワーデバイス、モジュールのほかビルや工場向けパワーエレクトロニクスソリューションや

このほか、開催地の福岡県をはじめ熊本県や長崎県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県といった九州各県および地域コンソーシアムがブースを設けた。さらに、台湾のITRI（工業技術研究院）やチエコ大使館といった海外からの出展もあった。

（副編集長 中村剛／日下千穂記者）

アムコーはICパッケージングプロセスを紹介

アムコーはICパッケージングプロセスを紹介



アムコーはICパッケージングプロセスを紹介

アムコーはICパッケージングプロセスを紹介

アムコーはICパッケージングプロセスを紹介

アムコーはICパッケージングプロセスを紹介

アムコーはICパッケージングプロセスを紹介

アムコーはICパッケージングプロセスを紹介

アムコーはICパッケージングプロセスを紹介

